

報道関係者各位

2010 年 6 月 24 日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel Core i7 と X58 チップセット用に最適化された DDR3 トリプルチャンネルメモリー
容量 12GB(4GB × 3 枚セット)、CL=9-9-9-24、DDR3-1600MHz
XMP 対応、アップグレード用のコネクタを搭載、Airflow ファン同梱
DOMINATOR シリーズ CMP12GX3M3A1600C9**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel Core i7 と X58 チップセット用に最適化された DDR3 トリプルチャンネルメモリー、容量 12GB (4GB × 3 枚セット) DOMINATOR シリーズ CMP12GX3M3A1600C9 を 2010 年 6 月 26 日より全国の PC パーツ専門店で発売開始いたします。

DOMINATOR シリーズ CMP12GX3M3A1600C9 は、PC3-12800(DDR3-1600MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリーです。トリプルチャンネル動作に最適な 4GB メモリーの 3 枚セットです。Intel Core i7 と X58 チップセットのプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されています。将来的なアップグレードやアクセサリを装着するための新しいコネクタを搭載しています。冷却用の AirFlow ファンを同梱したハイエンドモデルです。

DOMINATOR モジュールは、厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性を持ちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。



放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術 DHX (Dual-Path Heat Exchange) を搭載しています。DHX は伝導と対流という 2 つの熱消散経路で従来では難しかったプリント板(PCB)内の冷却を実現しています。

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去します。

Intel が独自に仕様を策定した規格、XMP (Extreme Memory Profile) に対応しています。SPD を拡張し自動的にメモリーのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

型番は CMP12GX3M3A1600C9。容量は 4GB × 3 枚の合計 12GB。メモリー規格は PC3-12800(DDR3-1600MHz)、デスクトップ用 240Pin DIMM メモリー。転送クロックは 1600MHz。CAS レイテンシは CL=9-9-9-24。DHX ヒートシンク搭載。サイズは 53 × 133mm。AirFlow ファンを同梱しています。永久保証が提供されます。

【CMP12GX3M3A1600C9 製品特徴】

・Intel Core i7 & X58 チップセット用に最適化されたメモリー

DOMINATORシリーズ CMP12GX3M3A1600C9 は、PC3-12800(DDR3-1600MHz)規格のデスクトップ用 240Pin DDR3 メモリーです。トリプルチャンネル動作に最適な 4GB メモリーの 3 枚セットです。Intel Core i7 と X58 チップセットのプラットフォームで最適なパフォーマンスが発揮できるよう設計されたモデルです。

・最適なチップのみを採用した DOMINATOR シリーズ

厳密なテストとスクリーニングを実施し、最適なものだけを選定したメモリーモジュールです。選別されたチップは高いオーバークロック耐性を持ちます。また各機器との相互運用性や各 IC の高周波性能、低レイテンシ性能のテストを徹底的に行い、厳しい基準をクリアしています。高い信頼性と最高のオーバークロック性能を提供します。

・放熱を最大化する独自の冷却技術 DHX

DHX (Dual-Path Heat Exchange) は、放熱を最大化すると同時に信頼性を向上させる CORSAIR 独自の冷却技術です。メモリーモジュールから熱を効果的に除去するために伝導と対流という 2 つの熱消散経路を利用しています。

・プリント板も冷却する優れた伝導熱消散

効率の良い伝導熱消散経路を構築するために、特別なプリント板(PCB)を採用しています。プリント板(PCB)のグラウンド層に銅を採用することにより、プリント板内の熱を内側のアルミニウムヒートシンクへ伝導させ効率よく消散します。この熱消散経路は非常に効果的に、チップの背面から生じる熱を除去します。

・オーバークロック機能 XMP 対応

XMP (Extreme Memory Profile) は、Intel が独自に仕様を策定した規格です。SPD を拡張し自動的にメモリーのオーバークロックを行なう機能です。XMP 対応マザーボードにて、簡単に安定したオーバークロックを行うことができます。

・将来的なアップグレードに備えた新コネクタ搭載

将来的なアップグレードやアクセサリを装着するための新しいコネクタを搭載しています。※現時点でアップグレードコネクタに対応する製品情報はありません。

・AirFlow ファン同梱

メモリ上部に搭載する特殊なメモリ冷却システム Airflow ファンを同梱しています。Airflow ファンは、60mm 制御ファンを 2 基搭載し、メモリーサブシステムに衝突気流を発生させ冷却いたします。ほとんどのマザーボードに簡単に取り付けすることができます。

・安心の永久保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は永久保証です。

【CMP12GX3M3A1600C9 製品詳細】

型番	CMP12GX3M3A1600C9
容量	12GB (4GB × 3 枚セット)
規格	PC3-12800(DDR3-1600MHz)

種類	240Pin DDR3-SDRAM Unbuffered DIMM
転送クロック	1600MHz
サイズ	基板サイズ: 39 × 133 mm 全体サイズ: 53 × 133mm
レイテンシ	9-9-9-24
XMP	XMP 9-9-9-24 values at 1600MHz、1.65V
トリプルチャンネル	対応
RoHS	適合
その他	Airflow ファン 同梱
ヒートシンク	DHX 搭載
保証	永久保証

【CMP12GX3M3A1600C9 発売詳細】

-型番

CMP12GX3M3A1600C9

-発売日

2010 年 6 月 26 日

-店頭予想売価

65,800 円前後 (OPEN)

-高解像度ダウンロード

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=755>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cmp12gx3m3a1600c9.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>